

Traitement des puces électroniques et nouveaux procédés d'interconnexion

Télécharger, Lire PDF



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Un ordinateur est une machine automatique de traitement de l'information, obéissant à .. Elle assure l'interconnexion entre tous les autres composants. .. en un seul composant électronique (ou puce électronique) appelé circuit intégré. .. La finesse de gravure d'un processeur

correspond au procédé de fabrication utilisé.

Les puces sont fabriquées sur des disques de silicium de 2 à 30 cm² et 0,2 à . Procédé de fabrication. PHASE 1 . correspond à un schéma électronique. .. ainsi de suite suivant le nombre de couches d'interconnexions nécessaire au wafer. Point de .. Unité de contrôle. Unité de traitement. Mémoire. Le microprocesseur.

Noté 0.0/5: Achetez Traitement des puces électroniques et nouveaux procédés d'interconnexion de Gilles Poupon: ISBN: 9782746220850 sur amazon.fr, des.

Données à caractère personnel + traitement (dès la simple collecte). = application de .. des interconnexions autres que celles nécessaires à l'objet défini ci-dessus. ... puces électroniques miniatures dénommées RFid, Smart Tag,. Transponder .. référence à l'apparition de procédés techniques nouveaux comme ceux de.

15 janv. 2010 . La taille de ces dispositifs, les matériaux utilisés, les procédés de fabrication . «La lumière, non l'électricité, est la clef des nouveaux ordinateurs » . Au terme d'une longue série d'opérations (photogravure, traitements chimiques ou .. la puce électronique, c'est-à-dire la création et l'interconnexion de très.

Implantation ionique et traitements thermoques en technologie silicium / annie . Traitement des puces électroniques et nouveaux procédés d'interconnexion.

1 sept. 2017 . sur des assemblages électroniques complexes - . les fabricants de composants électroniques développent continuellement de nouveaux dispositifs plus . température induites par le procédé de fabrication et le cycle de vie génèrent des . rupture au niveau des billes d'interconnexion, clivage de la puce.

La conception (ou le design) de circuits intégrés (ou puces électroniques) consiste à réaliser .. Le simulateur va simuler dans le temps chaque signal d'interconnexion en . On dispose donc d'une période d'horloge comme temps de traitement de l'unité . L'outil de synthèse d'un circuit synchrone procède généralement en.

7 avr. 2011 . (chefs de services mettant en œuvre des traitements) qu'aux . Elle dote la CNIL de nouveaux pouvoirs, et notamment un pouvoir de .. l'importance des manquements, elle procède au règlement des . (robot aspirateur de mail) des adresses électroniques de personnes physiques afin .. Interconnexion.

11 mai 2012 . Cette complémentarité permettra d'adapter matériaux et procédés . actuels des microprocesseurs et autres puces électroniques. . C'est également une démonstration de la capacité d'Arkema à développer de nouveaux copolymères et à . Au sein du CEA, l'Institut Leti (Laboratoire d'Électronique de.

ELE2003, Projets de circuits électroniques, 3 . ELE8812, Traitement et analyse d'images, 3 .. IND8120, Commercialisat. nouveaux produits et services, 3 .. économiques et sociales propres à un produit, procédé ou service pendant tout son cycle de ... de tension et de fréquence, transits de puissance et interconnexions.

30 avr. 2007 . fabrication de semi-conducteurs et autres articles électroniques . résiduaire de traitement des eaux usées par particules métalliques améliore la . précieux par procédé électrolytique ; enlèvement et récupération du ... surfaces et de la découpe des tranches de silicium en puces). .. L'interconnexion.

III État de l'art sur les circuits électroniques associés au traitement des données Le procédé consiste à construire de nouveaux caractères synthétiques à partir de facteurs obtenus par combinaisons linéaires ... L'architecture et la taille de la puce. . De switches qui réalisent les interconnexions entre les cellules.

Etude prédictive de fiabilité de nouveaux concepts .. 1.5 Procédé d'assemblage standard d'un boîtier . . 2 Fiabilité des composants électroniques .. interconnexions entre les puces sont plus courtes que les connexions classiques dans les.

A l'issue de ce traitement, le silicium est liquéfié à très haute température . Le procédé de fabrication High-K/Metal Gate utilise des wafers de 300 mm, . Un transistor agit comme un interrupteur, contrôlant le flux électrique au sein d'une puce. . C'est après cette étape que les transistors, interconnexions et autres contacts.

Sudoc Catalogue :: - Livre / Book Traitement des puces électroniques et nouveaux procédés d'interconnexion / sous la dir. de Gilles Poupon.

défaillance de cette technologie d'interconnexion. D'autre . Mots clés. Simulation multi-physique - Électronique de puissance - Électromagnétisme - Fils d'in- .. 1.6.1.3 Fatigue des brasures : puce - substrat et substrat - semelle . 33 .. 1.6 Procédé d'encapsulation des modules de puissance avec du gel silicone. 17.

de profil-zyak-2012. Traitement des puces électroniques et nouveaux procédés d'interconnexion. de hermes-science. Stratégies de modélisation et protection.

3 / Carte Nationale d'identité Electronique (CNIE) : Bienvenue à Gattaca ! .. Vous pouvez présenter de nouveaux papiers, faire appel à des témoignages. . qu'en cas de circonstances exceptionnelles, il puisse être procédé à la destruction .. Le traitement informatique des empreintes digitales est la grande spécialité du.

composant électronique - France / Ciblez les entreprises de 'Lille et Nord-Pas-de-Calais' .

Fournisseur de : Cartes à puce | électronique analogique et alimentation . instrumentation, laboratoire (équipement et procédés), mesure et métrologie,. . usinage de précision | plateaux de connexions, systèmes d'interconnexions.

téléservices offerts par l'administration, le développement d'identifiants uniques ou l'interconnexions de bases de données publiques. Ce document présente.

18 avr. 2002 . Pour suivre l'évolution des géométries des puces électroniques et de leur rapidité, . Régler les problèmes d'interconnexion des puces . Mais un substrat organique requiert une température de traitement inférieure à . Ce qui imposera le développement de nouveaux matériaux et procédés d'enduction.

d'interconnexion des signaux, Hammond. Electronics a ajouté trois . Electronique Composants & Instrumentation est une ... permettant de nouveaux parcours clients pour les ..

consommation d'énergie, ce système sur puce sera conçu dans le ... de traitement analogique du signal en ... selon le procédé multicouche.

9 mars 2017 . Aide-mémoire électricité, électronique de commande et de puissance, électrotechnique : formations ... interconnexions haut débit. Ndagijimana ... Traitement des puces électroniques et nouveaux procédés d'interconnexion.

ces entités informatiques (souvent portables) créent de nouveaux besoins (et donc des . capacités mémoires et des puissances de traitement des puces permet . 1) comporte un CPU relié à l'aide d'un bus d'interconnexion à différents blocs .. un premier brevet [15] relatif à un procédé transformant une carte à puce en.

Document: texte imprimé Traitement des puces électroniques et nouveaux procédés d'interconnexion / Gilles POUPON / Paris [France] : Lavoisier - 2011.

MECANOS Méthodologie pour les CADres applicatifs des Nouveaux Objets Sécurisés.

NEUROCOM Ou comment . SmartStack Empiler en 3D les puces électroniques ... procédés pour l'interconnexion hétérogène sur support souple de.

Adresse électronique* . Service chargé de la mise en œuvre du traitement (lieu d'implantation).

2 . Carte à puce .. Procédez-vous à des interconnexions de fichiers (échange de données entre .. L'application met en œuvre des procédés :.

Le circuit intégré (IC), aussi appelé puce électronique, est un composant . plusieurs types de composants électroniques de base dans un volume réduit, rendant le circuit facile à mettre en œuvre. . le procédé de fabrication d'interconnexion généralement utilisé entre un circuit intégré

. Consultez les procédés disponibles.

19 oct. 2017 . De là est née la bionique, qui intègre la biologie et l'électronique. . la mise au point de nouveaux composants et de circuits électroniques . le sera par l'électronique moléculaire et le traitement moléculaire de l'information (2000–2050). . pour les éclats de silicium servant à faire les puces électroniques.

13 févr. 2000 . Les principaux procédés étudiés peuvent être classés en plusieurs catégories: .. Le traitement concerne des quantités de déchets d'autant plus . microns), à l'interconnexion en trois dimensions des composants électroniques, et à .. Ce concept a pour objet de faciliter l'introduction de nouveaux services.

1 mars 2012 . Autant de procédés de fabrication pour le moins étonnants et dont on soupçonne . Le traitement de surface devient superflu, ce qui réduit le risque .. Plus largement, un nouveau modèle économique se construit, autour de la personnalisation. .. Les tranches de silicium contenant les puces électroniques.

5 juil. 2001 . Interopérabilité et interconnexion dans l'administration ... traitement judiciaire de la cybercriminalité (cf. ... carte à puce ou une clé électronique. ... La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à.

synchrones où les interconnexions entre les circuits électroniques intégrant les ... brutes, puis être inexistantes pendant le traitement avant d'augmenter à nouveau a u .. d'interconnecter plusieurs puces électroniques avec des performances ... Ainsi, dans le cas où les procédés d'intégration permettraient d'inclure non.

Le procédé de fabrication des puces passives est le point de départ .. Problématique générale de l'intégration des composants électroniques 22. 1.1.1.

En particulier, l'étude de l'impression par jet d'encre (procédé d'éjection des gouttes, . des procédés d'hybridation à l'échelle micro et nano, de puces en silicium . de report de composants par procédés Flip-Chip et d'interconnexions associées. . un atout majeur pour la détection avancée et le traitement des maladies.

Les composants électroniques comprennent les tubes à électrons (par exemple, tubes . Ces opérations consistent à positionner et à poser la puce du circuit intégré . Six grandes étapes sont communes aux procédés de fabrication de tous les . étape du traitement d'un composant à semi-conducteur est l'oxydation de la.

Traitement des puces électroniques et nouveaux procédés d'interconnexion. Voir la collection. De Gilles Poupon. Autres formats Prix Cultura.

31 mai 2013 . Conception des systèmes électroniques (cartes et SOC). 2 . le traitement de signaux et d'informations pris notamment dans les . Différentes étapes technologiques : procédés mis en œuvre et équipement . carte à puce, .). . cœurs de processeurs ouvre de nouveaux horizons d'applications tels que les.

22 mars 2012 . L'article 5 autorisait la création d'un traitement de données intégrant les données de . L'article 6 est relatif à l'accès aux données électroniques sécurisées par les . central, une carte à puce biométrique avec un fichier central ... Aucune interconnexion au sens de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier.

Découvrez et achetez Traitement des puces électroniques et nouveaux procédés d'interconnexion. Expédition dans la journée pour toute commande passée.

Microscope électronique en transmission à résolution atomique avec gestion com- plète des gaz . tale dans les domaines des procédés de dépôt de couches minces, de la Science .

Nouveaux matériaux organiques/hybrides semi-conducteurs . dans les puces électroniques, transistors à effet de champ (FETs), capteurs.

9 sept. 2009 . Traitement Des Puces Electroniques Et Nouveaux Procèdes D'Interconnexion Traite Egem Serie Electroni Traitement Des Puces Electr.

nouveaux procédés (Damascene). --> réactivité . fonctions réalisées, procédés de fabrication (niveaux d'interconnexion), produits assemblés. • Sévérité d'utilisation. – électronique embarquée, diversité climatique . Composants par puce.

La réflexion sur le développement et l'interconnexion des fichiers ne se présente .. l'implantation des puces électroniques contenant des données biométriques, .. TAJ (Traitement d'antécédents judiciaires)[36] qui sera géré par un Nouveau ... Le Projet AGDREF2, qui a été lancé en juin 2011 a procédé à une refonte.

26 févr. 2004 . Baptisé ADELE (ADministration ELEctronique), ce programme . parce qu'ils peuvent nécessiter de nouveaux traitements de données personnelles, le développement d'interconnexions voire la . d'applications de cartes à puce. .. Le recours systématique à des procédés de signature électronique,.

des composants électroniques et optoélectroniques. 0. Je tiens à remercier .. des technologies d'interconnexion entre les puces nues (circuits intégrés ou ... A ces procédés, il faut ajouter un nouveau venu qui est le procédé de collage .. la mise en pression et en température de l'ensemble: le traitement thermique de la.

8 août 2012 . Grâce à son antenne, la puce communique avec le lecteur qui . Les grands fabricants de composants électroniques : Hitachi, . Cette dernière a développé des procédés qui permettent d'imprimer . d'interconnexion aux serveurs contenant des informations relatives à des .. Le nouveau monde télécoms.

Traitement des puces électroniques et nouveaux procédés d'interconnexion [Livre] / sous la direction de Gilles Poupon. Langue : français.Publication : Paris.

Traité EGEM Electronique - Génie Electrique - Microsystèmes Électronique et . Traitement des puces électroniques et nouveaux procédés d'interconnexion.

permettant d'interconnecter les composants électroniques déposés à sa surface . d'influence des tests des liens d'interconnexions du FPIN, réduisant le nombre de ... Figure 1.2 Réseau sur puce (Yu et Ampadu, 2012) Les problématiques qu'apportent ces contraintes demandent la recherche de nouveaux substrats.

Des composants électroniques toujours plus petits et performants . l'Internet, de l'e-mail et des services web, ainsi que l'émergence de nouveaux réseaux sociaux. . Cette miniaturisation a conduit à une complexité colossale des puces : des . la dispersion relative des procédés augmentant avec la miniaturisation), voire.

La conception (ou le design) de circuits intégrés (ou puces électroniques) . Le simulateur va simuler dans le temps chaque signal d'interconnexion . période d'horloge comme temps de traitement de l'unité combinatoire qui est . L'outil de synthèse d'un circuit synchrone procède le plus souvent en plusieurs étapes :.

1 sept. 2009 . Electrodeposées en Electronique de Puissance. Ludovic Ménager, Quoc . d'interconnexion 3D sans brasure sur des puces de puissance sont.

Packaging et Interconnexion en Micro électronique. PACKAGING & INTERCONNEXION ..

L'intégration de la puce dans son environnement fait appelle à .. traversant. ➤ Pour les composants traversant, le procédé de brasage n'atteint pas.

1 févr. 2013 . Fiabilité des lignes de cuivre : interconnexion et inductance En changeant d'échelle, des phénomènes nouveaux apparaissent, non pas qu'ils n'existent ... L'intégration monolithique des composants suit des procédés de fabrication en .. Une puce électronique est composée de plusieurs niveaux qui.

1 sept. 2010 . silicium pour le traitement classique et quantique de . Les transistors mono-électroniques (SETs) sont des dispositifs ayant un . De plus, un procédé de gravure du silicium par plasma à couplage .. 2.14 Montage sur support de puce Ainsi, de nouveaux paradigmes de traitement de l'information sont.

SYSTEME DE PAIEMENT ELECTRONIQUE DANS UNE INSTITUTION FINANCIERE » .

Les enjeux et objectifs du nouveau système sont premièrement d'ordre sécuritaire, les . ü Un aspect matériel, qui concerne les infrastructures d'interconnexion. .. Le problème de traitement des erreurs est remonté dans les couches.

Un processeur multi-coeur ARM et un FPGA dans une seule puce 28 nm. . V et Arria V renforce la présence de cette gamme dans le marché du traitement embarqué. Les SoC FPGA Cyclone V et Arria V sont réalisés en procédé 28 nm low . automatiquement la logique d'interconnexion pour connecter les fonctions IP.

11 juil. 2017 . Electronique . IBM vient d'annoncer un nouveau procédé de gravure qui va permettre de . puces en créant entre elles une interconnexion haute vitesse. . Le traitement et le stockage de l'information numérique exigent une.

Traitement des puces électroniques et nouveaux procédés d'interconnexion - Gilles Poupon - Date de parution : 01/09/2011 - Hermes Science Publications.

20 oct. 2017 . Ces travaux s'inscrivent dans le développement d'un nouveau . devait intégrer de nouveaux réseaux d'interconnexion (optique, RF, . Dans ce procédé, chaque tuile a accès à deux modes de . Dans le cadre du projet ANR WiNoCoD, une méthode originale pour les communications au sein d'une puce.

23 août 2009 . Automatique et Traitement du Signal . particularité de permettre de forte densité d'interconnexions. D'autres . réalisés par ce nouveau procédé. Enfin, en . ont régi les performances et le coût des puces électroniques.

1 juin 2005 . a) La carte nationale d'identité électronique permettra utilement de sécuriser .. Un nouveau pacte social doit être conclu entre l'Etat et le citoyen32 ... (fabrication des puces, des cartes, des lecteurs, marché de la biométrie .. Constatant que les interconnexions de fichiers existent depuis déjà.

Title, Traitement des puces électroniques et nouveaux procédés d'interconnexion. Author, POUPON Gilles. Publisher, Lavoisier. ISBN, 274624179X.

Modèles de timbre pour les documents électroniques. 37 .. pour le traitement d'informations jusqu'au niveau Confidentiel-Défense, en mode d'exploitation . gestion de l'interconnexion de systèmes d'information de niveaux différents. .. une vulnérabilité du système ou de nouveaux risques créés par une évolution dans.

Les avancées de Diamac qui propose de nouveaux outils coupants... L'électroformage . Grâce au procédé LDS (Gravure directe par laser) de LPKF, il est.

30 oct. 1985 . Le bus série (26) d'interconnexion pour système de traitement . Procédé selon la revendication 16, caractérisé par une phase . et d'humidité, et dégradant pour la communication électronique. La fiabilité .. H/L est donc inversé à chaque nouveau transfert jusqu'à ce que le signal de trame devienne faux.

16 déc. 2010 . I.3 Problématique liée à l'assemblage de puces électroniques .. Ces procédés CVD se révèlent être extrêmement prometteurs pour réaliser de .. de ces interconnexions ainsi que l'introduction de nouveaux matériaux. Les.

9 janv. 2005 . Les interconnexions puce / environnement (boîtier ,substrats) . Un système électronique est constitué d'un ensemble de .. Ces procédés de report sont les mêmes que ceux utilisés dans une filiale MCM-C. Cette filière ,peu utilisée en . en plus, de substrats organiques ayant subi des traitements adaptés.